

e-mail: htanaka@tsuruoka-nct.ac.jp



田中 浩

TANAKA Hiroshi

機械工学科 教授

博士（工学）

◎所属学会：

日本機械学会，精密工学会，  
表面技術協会

◎専門分野：生産加工，表面処理

◎キーワード：

マイクロ加工，エッチング

今後取組みたいこと：

MEMS製品や金属部品加工の  
生産技術開発に携わりました。

今後は，シーズの研究を着実に進  
めると共に，部品の大きさに見合っ  
たミニ，マイクロ加工装置の製作，  
及び鶴岡高専の工作機械等を有効  
活用し，ファブラボ実現に取り組み  
ます。

<http://pr.tsuruoka-nct.ac.jp/~htanaka/>

機械的加工と化学的加工を擦り合わせた高速・高精度加工技術による社会貢献

【シーズ紹介】

○シリコンのマイクロ加工に関する研究

MEMSのキー加工技術の一つであるシリコン湿式エッチング加工の高速化，高精度化，生産性向上の研究に取り組んでいます。

○切削工具の寿命に関する研究

基礎実験によりミクロな視点も含め，寿命向上研究に取り組んでいます。

○材料の研磨加工に関する研究

ガラス等の高速・平滑研磨加工の研究に取り組んでいます。

